

11	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	-	+	+	+
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	-	+	+	+
15	Bauweisen 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	-	+	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	-	+	+	+

Tabelle 7: Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)

Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2)										
Einbauweise		Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht								
		außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen					
		un- günstig	günstig		günstig					
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A HSG III		WSG III B HSG IV		Wasservor- ranggebiete	
					Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
1	2	3	4		5		6			
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumengebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+1)	+1)	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasser-durchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+2)	+	+	-	+2)	-	+2)	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	+	-	-	-	-	-	+
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen	-	+3)	+	-	+3)	-	+3)	+3)	+

15	Bauweisen 13 unter Pflaster	-	+ ⁴⁾	+	-	+ ⁴⁾	-	+ ⁴⁾	+ ⁴⁾	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+ ⁵⁾	+	-	+ ⁵⁾	-	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	-	+	-	-	-	-	-	+

1) Die Verfüllung von Leitungsgräben ist nicht zulässig.

2) Zulässig, wenn Chrom, ges. $\leq 110 \mu\text{g/l}$, Vanadium $\leq 230 \mu\text{g/l}$, $\text{PAK}_{15} \leq 2,3 \mu\text{g/l}$, Phenole $\leq 90 \mu\text{g/l}$ und Chlorphenole $\leq 10 \mu\text{g/l}$.

3) Zulässig, wenn Blei $\leq 140 \mu\text{g/l}$, Cadmium $\leq 3,0 \mu\text{g/l}$, Chrom, ges. $\leq 230 \mu\text{g/l}$, Kupfer $\leq 160 \mu\text{g/l}$, Nickel $\leq 30 \mu\text{g/l}$, Vanadium $\leq 90 \mu\text{g/l}$ und Zink $\leq 180 \mu\text{g/l}$.

4) Zulässig, wenn Blei $\leq 220 \mu\text{g/l}$, Cadmium $\leq 4,0 \mu\text{g/l}$, Nickel $\leq 35 \mu\text{g/l}$, Vanadium $\leq 180 \mu\text{g/l}$ und Zink $\leq 250 \mu\text{g/l}$.

5) Zulässig, wenn „K“.

13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen	-	-	+1)	-	-	-	-	-	+1)
15	Bauweisen 13 unter Pflaster	-	-	+1)	-	-	-	-	-	+1)
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+2)	+3)	-	+2)	-	+2)	-	+2)
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	-	+4)	-	-	-	-	-	+4)

1) Zulässig, wenn Antimon $\leq 10 \mu\text{g/l}$, Blei $\leq 390 \mu\text{g/l}$, Cadmium $\leq 10 \mu\text{g/l}$, Chrom, ges. $\leq 440 \mu\text{g/l}$, Kupfer $\leq 270 \mu\text{g/l}$, Molybdän $\leq 55 \mu\text{g/l}$, Nickel $\leq 230 \mu\text{g/l}$, Vanadium $\leq 700 \mu\text{g/l}$, Zink $\leq 1.300 \mu\text{g/l}$, MKW $\leq 230 \mu\text{g/l}$, PCB, ges. $\leq 0,02 \mu\text{g/l}$, Chlorphenole $\leq 82 \mu\text{g/l}$, Chlorbenzole $\leq 1,9 \mu\text{g/l}$ und Tributylzinn-Kation $\leq 500 \mu\text{g/kg}$.

2) Zulässig wenn „K“, Nickel $\leq 180 \mu\text{g/l}$, und Zink $\leq 1.500 \mu\text{g/l}$ und Tributylzinn-Kation $\leq 500 \mu\text{g/kg}$.

3) Zulässig wenn „K“ und Tributylzinn-Kation $\leq 500 \mu\text{g/kg}$.

4) Zulässig, wenn Antimon $\leq 10 \mu\text{g/l}$, Molybdän $\leq 55 \mu\text{g/l}$, Chlorbenzole, ges. $\leq 2,0 \mu\text{g/l}$, PCB, ges. $\leq 0,02 \mu\text{g/l}$ und Tributylzinn-Kation $\leq 500 \mu\text{g/kg}$.